



株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
配当金支払株主確定日	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。 期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所市場第一部
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ（ https://www.samco.co.jp/ ）に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 （特別口座の口座管理機関）	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777（通話料無料） ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ（ https://www.tr.mufg.jp/daikou/ ）でも承っております。

（ご注意）

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ホームページのご紹介

最新のトピックスをはじめ、財務情報や会社情報を掲載しております。製品・アプリケーションの紹介や広報誌「samco NOW」など、掲載内容を充実させております。当社をよりご理解いただくためにもぜひアクセスしてください。

<https://www.samco.co.jp/>



トップページ





令和3年10月

左：代表取締役社長兼COO 川邊 史

右：代表取締役会長兼CEO 辻 理

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第42期（令和2年8月1日～令和3年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

当期（第42期）の事業環境と経営成績

半導体等電子部品業界におきましては、当社の関わる化合物半導体及び電子部品製造装置の販売マーケットにおいて、5G（第5世代移動通信システム）の立ち上がりを背景にしたスマートフォン向けや自動車向けセンサーなどの電子部品分野、あるいはMEMS（Micro Electro Mechanical Systems＝微小電気機械素子）といった先端分野での研究開発投資が幅広い企業で進み、本格生産への移行が着実に進んでおります。また、感染症の影響により一時的に減少していたスマートフォンや自動車向けの半導体等電子部品の需要が急回復し、加えて感染症危機のもとでデジタル化

が急速に進んでいることにより、半導体等電子部品製造装置の需要は拡大しております。

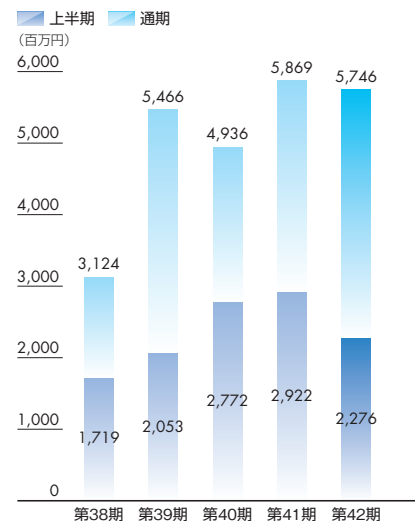
このような状況のもと、当社ではオプトエレクトロニクス分野のマイクロLEDや通信用レーザー、電子部品分野の高周波デバイス、パワーデバイス、MEMS、各種センサー等向け製造装置の受注活動への注力による既存事業の推進に加え、新規事業（ヘルスケア事業）の創出に向けた技術開発への取り組みや、水蒸気を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma（アクアプラズマ）洗浄装置の拡販による新たな事業領域の拡大に注力してまいりました。また、感染症の拡大により、出社制限や出張、海外渡航の禁止等の営業活動での制約はありましたが、当社の生産体制、及び国内やアジア地域を中心とした出荷業務に対する影響は軽微に留まりました。

その結果、国内売上高は3,300百万円（前期比0.5%増）、海外売上高は2,445百万円（前期比5.4%減）となり、海外売上高比率は42.6%となりました。また、当事業年度の受注高は6,816百万円（前期比28.0%増）となり、当事業年度末の受注残高は2,604百万円（前期比69.7%増）となりました。一方、海外出荷装置の据付（設置）業務や立ち上げ作業の遅れが発生しており、課題として残ることとなりました。

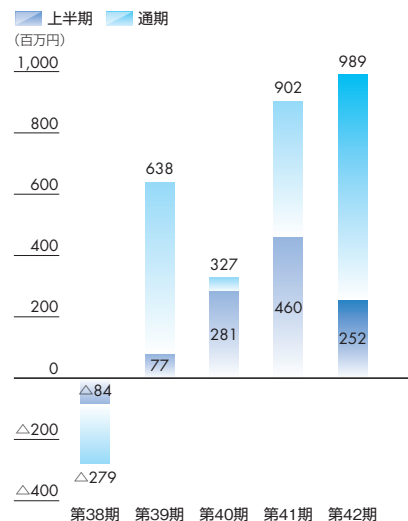
以上の結果、当期における業績は、売上高が5,746百万円（前期比2.1%減）、営業利益は989百万円（前期比9.7%増）、経常利益は1,044百万円（前期比12.6%増）、当期純利益は755百万円（前期比19.1%増）となりました。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

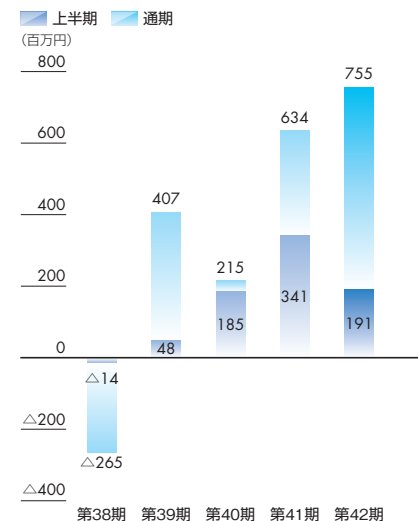
■ 売上高



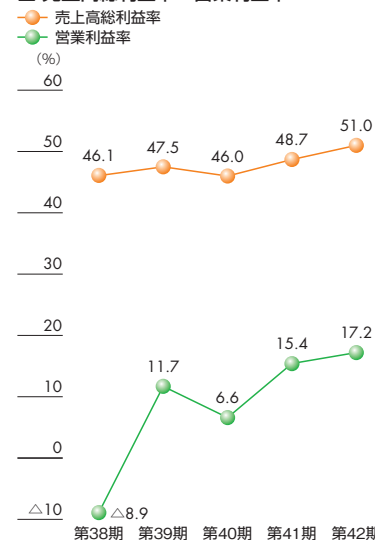
■ 営業利益



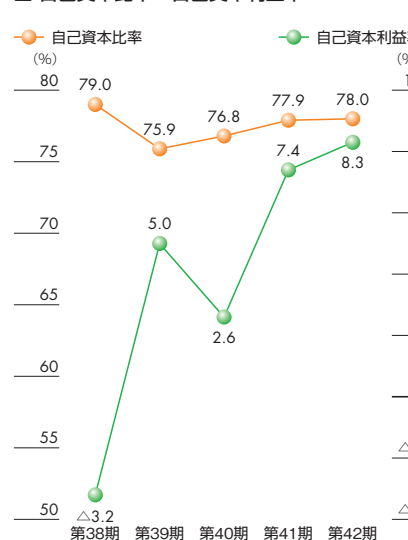
■ 当期純利益



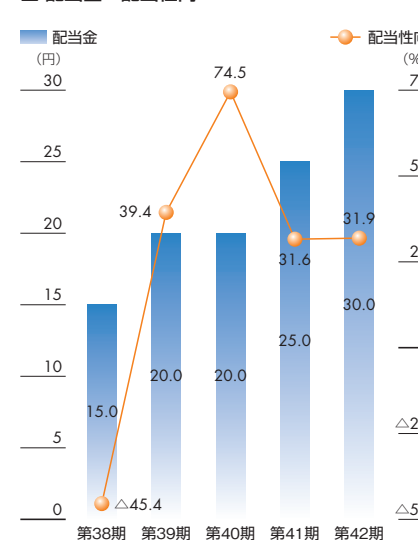
■ 売上高総利益率・営業利益率



■ 自己資本比率・自己資本利益率



■ 配当金・配当性向

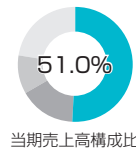


品目別販売状況

■ エッチング装置

売上高 2,931百万円 前期比 13.0%減

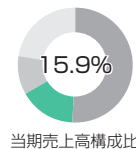
▶ オプトエレクトロニクス分野の半導体レーザー、電子部品分野での高周波デバイスやパワーデバイスにおける各種絶縁膜、保護膜形成用途での販売等により、売上高は2,931百万円となりました。



■ CVD装置

売上高 912百万円 前期比 5.3%減

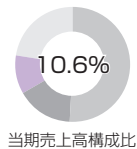
▶ 電子部品分野での高周波デバイス、パワーデバイスや各種センサー用、オプトエレクトロニクス分野のマイクロLED用など幅広い用途での販売等により、売上高は912百万円となりました。



■ 洗浄装置

売上高 610百万円 前期比 8.4%減

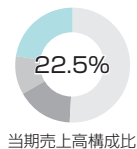
▶ 電子部品分野でのパワーデバイスにおけるウェハーの表面有機物除去用の生産機や、オプトエレクトロニクス分野の半導体レーザーの洗浄用の生産機の販売等により、売上高は610百万円となりました。



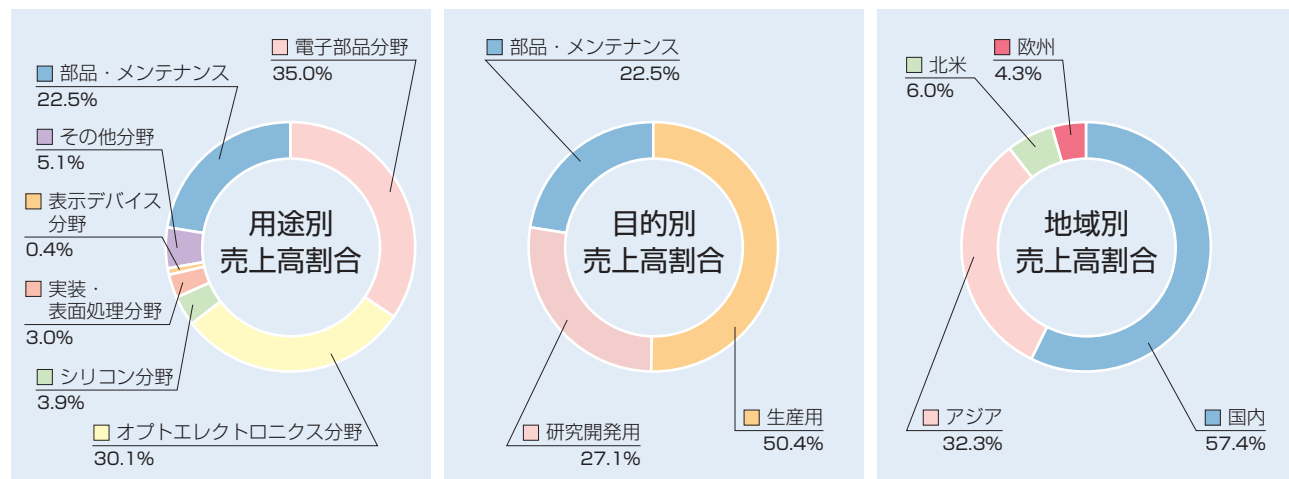
■ その他

売上高 1,291百万円 前期比 48.4%増

▶ 既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造作業などが大幅に増加し、売上高は1,291百万円となりました。



売上高割合状況



サムコの製品

エッチング装置



ICPエッチング装置
半導体の加工を得意としており、次世代パワーデバイスの材料である窒化ガリウム（GaN）や炭化シリコン（SiC）などの加工が可能です。

微細加工

CVD装置



液体ソースCVD®装置
反応性の気体を半導体基板上に供給し、プラズマなどで化学反応させることで薄い膜を堆積させる装置です。半導体を水分やほこりから保護したり、絶縁性を持たせたりする目的で使用されます。当社は独自の原料を用いた液体ソースCVD®（Chemical Vapor Deposition＝化学気相成長）法に特長があり、比較的低温での高速成膜が可能です。

薄膜形成

洗浄装置



プラズマクリーナー
液体を用いないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて半導体基板の表面を洗浄します。独自に開発したAqua Plasma®は銀や銅の表面還元や樹脂の接合など幅広い分野に応用されています。また、紫外線（UV）とオゾン（O₃）を用いたUVオゾンクリーナーも取り揃えています。

洗浄・表面処理

サムコの事業分野

オプトエレクトロニクス分野

照明や光通信に使われるLEDやLDなどの発光デバイス

電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりするデバイスで、主に化合物半導体で作られています。自動車のヘッドライトに用いられる高輝度LEDやLD、データセンターで用いられる近距離通信用のLDや光導波路などのデバイスがあります。



電子部品分野

IoT(Internet of Things)を支えるキーデバイス

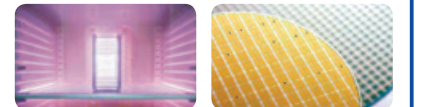
各種センサー・MEMS（Micro Electro Mechanical Systems＝微小電気機械素子）・高周波フィルタなどの分野です。スマートフォンに多数搭載される高周波フィルタは、IoT時代を迎えその応用製品が飛躍的に増加しています。



実装・表面処理分野

電子機器の小型化、軽量化および高機能化を実現する重要なプロセス

パッケージ工程前のドライ洗浄分野です。最先端パッケージとして注目が高まるファンアウトウエハーレベルパッケージ（FOWLP）をはじめ、高機能な電子機器を製造するための信頼性の高い洗浄が要求されます。



財務諸表

貸借対照表

単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (令和3年7月31日現在)	前 期 (令和2年7月31日現在)
(資 産 の 部)		
流 動 資 産	7,714,562	7,649,268
現金 及 び 預 金	4,826,002	5,321,544
受 取 手 形	10,672	17,460
電 子 記 録 債 権	41,176	59,491
売 掛 金	1,858,335	1,533,929
た な 卸 資 産	850,666	628,659
そ の 他	127,908	88,353
貸 倒 引 当 金	△ 199	△ 171
固 定 資 産	4,355,307	3,625,106
有 形 固 定 資 産	3,648,823	3,002,999
建 物	323,774	351,737
構 築 物	1,787	1,959
機 械 及 び 装 置	54,867	66,940
車 両 運 搬 具	6,868	8,005
工 具、器 具 及 び 備 品	24,514	19,472
土 地	3,231,918	2,530,836
リ ー ス 資 産	4,014	9,039
建 設 仮 勘 定	1,076	15,008
無 形 固 定 資 産	8,613	12,293
投 資 そ の 他 の 資 産	697,869	609,813
投 資 有 価 証 券	305,047	201,621
関 係 会 社 株 式	25,207	25,207
繰 延 税 金 資 産	100,662	130,941
そ の 他	266,952	252,042
資 産 合 計	12,069,869	11,274,375

科 目	当 期 (令和3年7月31日現在)	前 期 (令和2年7月31日現在)
(負 債 の 部)		
流 動 負 債	1,821,212	1,651,662
買 掛 金	646,532	246,514
短 期 借 入 金	700,000	700,000
未 払 金	125,178	140,237
未 払 費 用	37,407	38,320
未 払 法 人 税 等	175,929	280,398
前 受 金	24,029	65,339
預 り 金	34,225	32,454
賞 与 引 当 金	23,100	23,600
役 員 賞 与 引 当 金	30,000	24,391
製 品 保 証 引 当 金	18,400	27,000
そ の 他	6,410	73,406
固 定 負 債	838,452	834,671
退 職 給 付 引 当 金	460,095	437,415
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	375,291	387,275
そ の 他	3,065	9,980
負 債 合 計	2,659,665	2,486,334
(純 資 産 の 部)		
株 主 資 本	9,248,037	8,693,819
資 本 金	1,663,687	1,663,687
資 本 剰 余 金	2,079,487	2,079,487
資 本 準 備 金	2,079,487	2,079,487
利 益 剰 余 金	5,517,047	4,962,050
利 益 準 備 金	59,500	59,500
そ の 他 利 益 剰 余 金	5,457,547	4,902,550
別 途 積 立 金	3,867,000	3,867,000
繰 越 利 益 剰 余 金	1,590,547	1,035,550
自 己 株 式	△ 12,184	△ 11,405
評 価 ・ 換 算 差 額 等	162,165	94,221
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	162,165	94,221
純 資 産 合 計	9,410,203	8,788,040
負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,069,869	11,274,375

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (自令和2年8月 1 日 至令和3年7月31日)	前 期 (自令和元年8月 1 日 至令和2年7月31日)
売 上 高	5,746,666	5,869,982
売 上 原 価	2,815,063	3,012,748
売 上 総 利 益	2,931,602	2,857,234
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,942,179	1,955,001
営 業 利 益	989,423	902,233
営 業 外 収 益	59,906	40,180
営 業 外 費 用	4,558	14,649
経 常 利 益	1,044,772	927,763
特 別 損 失	－	17,424
税 引 前 当 期 純 利 益	1,044,772	910,339
法人税、住民税及び事業税	288,530	291,051
法 人 税 等 調 整 額	419	△ 15,452
当 期 純 利 益	755,822	634,740

Point ▶ 売上高

5Gの本格導入に向けてオプトエレクトロニクス分野や電子部品分野が売上を牽引。

売上高は前期比2.1％減の5,746,666千円。

国内売上高は、前期比0.5％増の3,300,915千円。

海外売上高は、前期比5.4％減の2,445,750千円。

売上高総利益率は、51.0％へ向上。

Point ▶ 販売費及び一般管理費

経費の増加抑制努力により前期比0.7％減の1,942,179千円。

販管費率は前期の33.3％から33.8％へ0.5ポイント増加。

Point ▶ 営業外費用

円安による為替差益が30,839千円発生。

Point ▶ 損益分岐点

損益分岐点売上高は3,862,302千円。

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (自令和2年8月 1 日 至令和3年7月31日)	前 期 (自令和元年8月 1 日 至令和2年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	493,478	868,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,741	33,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,026	△ 171,712
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,072	△ 6,277
現金及び現金同等物の増減額	△ 511,217	723,362
現金及び現金同等物の期首残高	3,476,531	2,753,168
現金及び現金同等物の期末残高	2,965,313	3,476,531

Point ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：税引前当期純利益1,044,772千円、仕入債務の増加400,018千円、減価償却費94,589千円。

マイナス要因：法人税等の支払387,816千円、売上債権の増加299,302千円、たな卸資産の増加222,006千円。

Point ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー

プラス要因：定期預金の払戻による収入2,531,441千円。

マイナス要因：定期預金の預入による支出2,546,159千円、有形固定資産の取得による支出780,215千円。

Point ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー

マイナス要因：配当金の支払200,824千円、リース債務の返済による支出8,423千円。

中期経営計画

当社の主たる事業領域である化合物半導体及び電子部品製造装置のマーケットでは、IoT、自動運転、ロボット、AI、5G等の技術革新の時代が本格的な幕開けを迎えつつあり、関連企業は設備投資に対して前向きな姿勢を示しております。

このような中であって、当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」という経営理念のもと、研究開発型企業として成長してきた高度な技術力に更に磨きをかけると同時に、蓄積した技術を生産機市場で活かすことで、事業規模の拡大を図っております。加えて、当社のコアテクノロジーである「薄膜技術」は医療、バイオ、環境といったライフサイエンス及びエネルギー分野に活かすことが可能であり、中期的には当社の新規事業、新分野として成長させることを目指し、積極的に事業を展開してまいります。

こうした状況を踏まえ、令和3年8月よりスタートさせた中期経営計画（令和3年8月1日～令和6年7月31日）においては、“グローバル中堅企業へ”をスローガンとし、以下の重点課題に取り組んでおります。

課題

1 海外販売の拡大

当社の事業を成長軌道に乗せるため、海外販売の拡大を最大の目標に掲げ、将来の成長期待の高い海外への事業展開を積極的に行っております。海外への出荷装置の据付（設置）業務や立ち上げ作業につきましては、渡航制限のある地域等では、海外の顧客及び現地従業員と本社との間でオンラインシステムを用いた立ち上げ作業を行います。引き続き現地のサービス人員を強化するとともに、本社からのサポート体制を充実させ、海外売上高比率50%以上の達成を目指してまいります。



2 成膜装置販売の拡大

当社の属する半導体等電子部品製造装置市場は、常に技術開発の競争、顧客ニーズの多様化や高度化、グローバル化が加速しており、継続的な研究

開発活動による高付加価値・高性能製品の開発、新製品の市場投入を進めることで、市場での競争力を維持し続けることが命題であります。

第2生産技術棟内に開設した成膜装置（CVD装置、ALD装置等）のデモルームの活用によりプロセス開発を強化し、国内外企業からのサンプルのデモ処理や、大学・研究機関・企業など社外との共同研究により、顧客との連携を拡大していく計画であります。



3 部品・サービス売上の拡大

生産機の販売拡大に伴い部品・サービス事業の重要性が高くなってきており、重点課題として積極的に対応することにより、事業活動を拡大していく計画であります。



4 新規事業の立ち上げ

現在の製品群であるCVD装置、エッチング装置、洗浄装置を新たな事業領域へ展開し、新規事業として業績への寄与を目指しております。具体的には、第38期よりヘルスケア分野へ進出し、医療分野における滅菌装置の開発、及び、医療計測分野におけるヘルスケアチップの加工装置の開発・販売を行っております。

5 更なる成長に向けた人材育成・活用

当社にとって最大の資産は人材であります。既存の人材を強化・育成し、新たに優秀な人材を獲得することが当社の企業価値を決定し、成長の大きな原動力となります。令和2年7月期より重点課題として人材育成の強化に着手しており、外部講師を招いた部長塾や課長塾を開催いたしました。

以上の課題を克服し、第43期は売上高6,700百万円、第44期は7,700百万円、第45期は8,800百万円という中期経営計画の目標達成を目指します。

○技術開発、生産拠点を目的とした土地を取得

3月24日付にて、本社近隣地の土地（2,032平方メートル）を取得いたしました。

現在のコア事業である半導体及び電子部品製造装置事業の拡大に加え、新規事業（ヘルスケア事業）の更なる推進など、中長期的な業容拡大を見据え、将来の技術開発・生産拡大のための拠点整備を目的としたものであります。



○IIT Delhiの薄膜太陽電池開発にCVD装置が採用

インド工科大学デリー校（IIT Delhi）のHIT（Heterojunction with Intrinsic Thin-layer）太陽電池の開発に、当社のマルチチャンバーCVD装置が採用されました。

インドでは、一人当たりのエネルギー消費量が増加しており、国を挙げてCO₂排出量の削減に取り組んでいることからHIT太陽電池の必要性が高まっています。また、IIT Delhiは産業研究開発ユニット（IRD）を通じて、最先端のエネルギーエコシステムの研究を奨励しています。



○サムコ科学技術振興財団が2021年度 第5回研究助成者5名に研究助成金を贈呈

サムコ科学技術振興財団は、6月25日に第5回 薄膜技術に関する研究助成の対象者5名を決定いたしました。助成対象者5名には、9月15日に開催されました研究助成金贈呈式において、それぞれ200万円、総額1,000万円が贈呈されました。式典後には、2019年ノーベル化学賞受賞者の旭化成株式会社 名誉フェロー 吉野彰様による記念講演が行われました。



※研究助成対象者5名とその研究課題につきましては財団のホームページをご覧ください。
<https://www.samco.co.jp/foundation/prize/>

■ 会社概要

商 号	サムコ株式会社
英 文 社 名	SAMCO INC.
設 立	昭和54年（1979年）9月
事 業 内 容	半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
資 本 金	1,663,687,288円
従 業 員 数	178名
本 社	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地 TEL(075)621-7841 FAX(075)621-0936
国 内 拠 点	本社（京都）、東日本営業部（東京）、東海支店（愛知）、つくば営業所（茨城）、福岡営業所（福岡）
海 外 拠 点	米国（カリフォルニア・ニュージャージー）、台湾、シンガポール、中国（上海・北京）、マレーシア
研 究 拠 点	本社研究開発センター（京都）、オプティフィルムズ研究所（米国）

■ 役員

代表取締役会長兼CEO	辻 理
代表取締役社長兼COO	川 邊 史
取 締 役 執 行 役 員	山 下 晴 彦 宮 本 省 三 佐 藤 清 志
社 外 取 締 役	村 上 正 紀 高 須 秀 視
常 勤 監 査 役	辻 村 茂
社 外 監 査 役	木 村 隆 之 西 尾 方 宏
常 務 執 行 役 員	竹之内 聡一郎
執 行 役 員	外 山 信 一 関 仲 修 ピーター・ウッド 本 山 慎 一 松 出 和 男

■ 株式の状況

発行可能株式総数	14,400,000株
発行済株式の総数	8,042,881株
株主数	9,089名

■ 大株主の状況

株 主 名	持株数(株)	持株比率(%)
辻 理	982,607	12.2
サムコエンジニアリング(株)	850,282	10.6
(一財)サムコ科学技術振興財団	800,000	9.9
(株)日本カストディ銀行(信託口)	237,400	3.0
辻 一美	201,465	2.5
辻 猛	183,615	2.3
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	167,600	2.1
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	125,038	1.6
立田 利明	103,099	1.3

■ 所有者別株式分布状況

